No title available

Publication number: JP5345137
Publication date: 1993-12-27

Inventor: NAGAO MASAMICHI

Applicant: MIKUROTETSUKU TSUU ONE KK

Classification:

- international: B02C7/10; B02C7/11; B02C7/12; B02C7/17; B02C7/00;

(IPC1-7): B02C7/10; B02C7/11; B02C7/12; B02C7/17

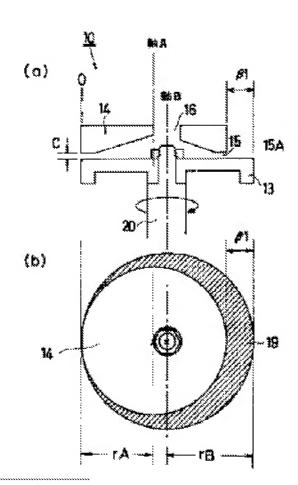
- European:

Application number: JP19920178922 19920615 **Priority number(s):** JP19920178922 19920615

Report a data error here

Abstract of **JP5345137**

PURPOSE:To provide a grinder cooling a rotary disc being a grinding tool to prevent heat accumulation and generating no deterioration or seizure of a ground matter. CONSTITUTION:The center axis of a fixed disc 14 and the rotary shaft of a rotary disc 13 are arranged in the positional relation of different parallel axes. The diameter of the rotary disc 13 is made larger than that of the fixed disc 14 and, when both discs are superposed one upon another, an exposed surface 19 is generated on the surface of the rotary disc.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-345137

(43)公開日 平成5年(1993)12月27日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 0 2 C	7/10		7824-4D		
	7/11	A	7824-4D		
	7/12		7824-4D		
	7/17		7824-4D		

審査請求 未請求 請求項の数7(全 8 頁)

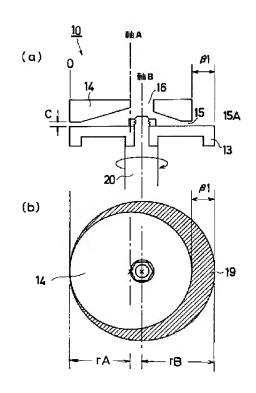
(21)出願番号	特願平4-178922	(71)出願人	591278600
			株式会社ミクロテック・ツーワン
(22)出願日	平成4年(1992)6月15日		福岡県福岡市中央区天神2丁目4番12号
		(72)発明者	長尾 正道
			福岡県宗像郡福間町光陽台5-10-8
		(74)代理人	弁理士 及川 昭二
(PS) MOX H	1/// 1 (1002/ 0/110)		長尾 正道 福岡県宗像郡福間町光陽台 5 - 10 - 8

(54) 【発明の名称】 グラインダ

(57)【要約】

【目的】 粉砕ツールである回転ディスクを冷却して蓄 熱を防ぎ、粉砕物の変質や焼付がおきないグラインダを 提供する。

【構成】 固定ディスク14の中心軸と回転ディスク1 3の回転軸を異なった並行軸の位置関係に配置する。回 転ディスク13の直径を固定ディスク14の直径よりも 大径となるように形成し、両ディスクを重ね合わせた際 に、回転ディスク面上に露出面19が生じる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 相対する1組の回転ディスクと固定ディスクを備え、この両ディスクの対向面に研削面が形成され、この両ディスクの研削面を所定のクリアランスをもって相対し、前記回転ディスクが駆動手段に連結したシャフトに固定されてなるグラインダであって、

前記固定ディスクの中心軸と前記回転ディスクの回転軸 を異なった並行軸の位置関係に配置するとともに、前記 回転ディスクの直径を前記固定ディスクの直径よりも大 径となるように形成し、両ディスクを重ね合わせた際 10 に、前記回転ディスク面上に露出面が生じる構成とした ことを特徴とするグラインダ。

【請求項2】 前記回転ディスクの上方あるいは下方の 少なくとも一方側に、作動時に誘導した空気を吹き付け て前記回転ディスク側の研削面に生じる研削熱の放散冷 却を行う冷却手段を配備してなる請求項1記載のグライ ンダ。

【請求項3】 前記回転ディスクと固定ディスクの重ね合わせによって生じる露出面を三日月形の露出面として形成するよう前記回転ディスクと固定ディスクを重ね合わせ、前記冷却手段を、誘導した空気を前記三日月形の露出面に吹き付け得る位置に配設した請求項2記載のグラインダ。

【請求項4】 前記冷却手段が、前記回転ディスク及び 固定ディスクを収容するハウジングと、該ハウジング内 に形成される粉砕チャンバと、該粉砕チャンバの排出口 に設けた負圧吸引手段と、前記粉砕チャンバ内の回転ディスクの上方又は下方の少なくとも一方側に設けた吸引 口を具備して構成されている請求項2記載のグライン ダ。

【請求項5】 前記回転ディスクが、金属製のベース と、このベース表面に固定されて林立したダイヤモンド 粒、CBN粒、超硬金属粒等の砥粒より形成され、その 砥粒面が研削面として形成されている請求項1記載のグ ラインダ。

【請求項6】 前記回転ディスクが、セラミックスにより形成され、かつその表面に粗面状の研削面が形成されている請求項1記載のグラインダ。

【請求項7】 前記固定ディスクが、セラミックス、金属製台金等により形成されているとともに、粉砕原料供給用の供給口を備え、かつその供給口の中心が前記固定ディスクの中心より偏倚した位置に形成されている請求項1記載のグラインダ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、相対する1組の回転ディスクと固定ディスクを備えた微粉砕用のグラインダに関するものであり、特に、固定ディスクの中心軸と回転ディスクの回転軸を同軸とせずに異なった並行軸の位置関係に配置するとともに、回転ディスクの直径を固定デ 50

2

ィスクの直径よりも大径となるように形成したグライン ダに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来この種のものとして、相対する1組の回転ディスク113と固定ディスク114の対向面に研削面115が形成され、この両ディスクの研削面115を所定のクリアランスCをもって相対し、固定ディスク114の中心軸と回転ディスク113の回転軸を同一軸上に配置し、回転ディスク113の研削面が固定ディスク114の同心円上を回転するよう構成するとともに、粉砕ツールを固定側、回転側ともセラミックス、あるいは金属製等で形成し、回転ディスク側の研削面に溝目123をつけたものが知られている(図1参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この従来技術にあって は、相対する1組のディスクによって構成されたグライ ンダに粉砕目的物を投入して微粉砕を行う場合、通例固 定ディスク側に比べ回転デイスク側に多大の負荷がかか るため、粉砕時の熱の発生及び熱の蓄積は主に回転ディ スク側に生じる。更に、固定ディスク114の中心軸と 回転ディスク113の回転軸が同一軸上の位置関係にな るため、中心軸あるいは回転軸より同じ距離にある、両 ディスクにより形成される研削面115の同一箇所(部 位)が、連続的な研削によって摩滅し疲労することが多 々起こる。このため、図1に示す先行技術にあっては、 ①回転ディスク側の研削面に熱が蓄積され易く、回転デ ィスク側の研削面の表面温度が短時間のうちに上昇し て、粉砕物の発熱焼付けを起こし易い;②研削時に負荷 が集中する研削面の特定部位(例えば、図2の115 30 A) にのみ摩耗と疲労が生じ、結果として回転ディスク 自体の寿命が短くなる(図2参照);③特に、熱変生を 生じ易い粉砕物質(原料)を粉砕するために、一旦凍結 した後で微粉砕することが行なわれているが、この種粉 砕物質の粉砕作業が極めて面倒である;という問題点が った。

【0004】従って、本発明の目的は、粉砕ツールである回転ディスクを冷却して蓄熱を防ぎ、粉砕物の変質や焼付がおきないグラインダを提供することにある。本発明の他の目的は、粉砕ツールの疲労が少なく寿命の長いグラインダを提供することにある。本発明のもう一つの他の目的は、粉砕物が発熱によって変質し易い物質の場合でも、カッティング粉砕が可能でしかも粉砕物の粒径を均一に保持することが容易なグラインダを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、相対する1組の回転ディスクと固定ディスクを備え、この両ディスクの対向面に研削面が形成され、この両ディスクの研削面を所定のクリアランスをもって相対し、前記回転ディスクが駆動手段に連結したシャフトに固定されてなるグラ

.3

インダであって、前記固定ディスクの中心軸と前記回転 ディスクの回転軸を異なった並行軸の位置関係に配置す るとともに、前記回転ディスクの直径を前記固定ディス クの直径よりも大径となるように形成し、両ディスクを 重ね合わせた際に、前記回転ディスク面上に露出面が生 じる構成としたことを特徴とするグラインダである。ま た、上記回転ディスクの上方あるいは下方の少なくとも 一方側に、作動時に誘導した空気を吹き付けて上記回転 ディスク側の研削面に生じる研削熱の放散冷却を行う冷 却手段を配備するとよい。

[0006]

【作 用】回転ディスクの研削面が1回転毎に固定ディ スクから離れ空気に触れて放熱し、その後再び固定ディ スクにもぐり込む動作を繰り返すことによって回転ディ スクへの蓄熱を防ぐ。

[0007]

【実施例】以下本発明の実施例を図面を参照しながら詳 細に説明する。図3は本発明に係るグラインダを示し、 図3 (a) はその断面略図、図3 (b) はその平面図で ある。これらの図において、グラインダ10は、相対す る1組の回転ディスク13と固定ディスク14を備えて なり、この両ディスクの対向面は研削面15として形成 され、この両ディスクの研削面15は所定のクリアラン スCをもって相対している。そして、前記回転ディスク 13は駆動手段(図示せず)に連結したシャフト20に 固定されている。

【0008】前記固定ディスク14の中心軸Aと前記回 転ディスク13の回転軸Bは異なった並行軸の位置関係 に配置され、前記回転ディスク13の直径rBを前記固 し、両ディスクを重ね合わせた際に、前記回転ディスク 面上に露出面19が生じる構成となっている。また、前 記回転ディスク13の上方あるいは下方の少なくとも一 方側には、作動時に、誘導した空気を吹き付けて前記回 転ディスク側の研削面に生じる研削熱の放散冷却を行う 冷却手段80が配備される(図4参照)。

【0009】前記固定ディスク14の中心軸Aと前記回 転ディスク13の回転軸Bの位置関係は、図3では最大 幅 β 1 を有する三日月形の露出面が生じるよう前記回転 ディスク13と固定ディスク14を重ね合わせてある が、図5に示すように前記固定ディスク14の中心軸A と前記回転ディスク13の回転軸Bをやや接近させた位 置関係に配置するようにしてもよい(図3と図5では、 $\beta 2 + \alpha 2 = \beta 1$ の関係がある)。いずれにしろ、前記 固定ディスク14の中心軸Aと前記回転ディスク13の 回転軸Bの位置関係は、異なった並行軸の位置関係に配 置することが肝要である。図3に示す実施例では、前述 のように露出面19を三日月形の露出面として形成し、 前記冷却手段80は誘導した空気を前記三日月形の露出 面に吹き付け得る位置に配設してある。この場合、前記 50 回転ディスク13の研削面15Aが、固定ディスク14 から離れて三日月形の空気接触面(露出面)となってい る場所に、外部から空気を誘導し放熱冷却することによ り行う。

【0010】前記回転ディスク13は、金属製のベース 13Aと、このベース表面に基部を埋め込んで固定させ 林立させて一部が外部に突出した、直径100~240 μm程度のオーダーのダイヤモンド粒、CBN粒、超硬 金属粒等の砥粒13Bより形成されている。この砥粒の 10 露出面は前記回転ディスク側の研削面15Aを形成する (図6参照)。また図7に示すように、回転ディスク2 3を、セラミックスにより形成し、その表面を粗面状に して研削面を形成するようにしてもよいこと勿論であ る。又回転ディスク13の底面側中央部を肉薄に形成し て蓄熱を防ぎ、熱の伝導時間を短縮し、その裏面側に空 気を誘導して絶えず放熱冷却を施すことにより冷却効率 を高めることが可能である。

【0011】一方、前記固定ディスク14、24は、ア ランダム等のセラミックス、金属製台金等により形成さ 20 れ、粉砕原料供給用の供給口16、26を備えている。 そして、この供給口16、26の中心は固定ディスク1 4、24の中心より偏倚した位置に形成されている。ま た、図8に示すように、固定ディスク34側の研削面1 5 Bの研削力をより高めるために、ダイヤモンド粒、C BN粒、超硬金属粒等を埋め込み林立させ一部を突出さ せて形成してもよいこと勿論である。

【0012】次に、図9に示すグラインダを組み込んで 構成した微粉砕機を図10に示す。これらの図におい て、符号44は、回転ディスク43とのクリアランスC 定ディスク14の直径rAよりも大径となるように形成 30 をもち、含みの高さTの逆凹型の固定ディスク、45は 研削面、49は露出面を示す。この微粉砕機における冷 却手段80は、前記回転ディスク43及び固定ディスク 44を収容したハウジング81と、該ハウジング内に形 成される粉砕チャンバ87と、該粉砕チャンバ87の排 出口82に設けた負圧吸引手段(負圧吸引パイプ)88 と、前記粉砕チャンバ内の回転ディスク43の上方及び 下方に設けた吸引口86を具備している。かくして、前 記負圧吸引手段88により吸引を行い、前記吸引口86 より、外気を回転ディスク43の上方及び下方に誘導噴 40 射して回転ディスク43の蓄熱を防ぐ。

> 【0013】次に、図10の微粉砕機を用い、回転ディ スク43の研削面を空冷しながら各種粉砕物の微粉砕を 試みたところ以下の試験結果を得た。

「試験例1]

- (1) 固定デイスクは凹型。外径Mは190mm。材質 はアランダム。粒度は80番。含みTの高さは中心より 45mmの位置の円周部で4mm(図9参照)。
- (2)回転デイスクの研削面は水平。外形しは240m m。ステンレス製台金上に超硬金属粒(WC)のサイズ 60番のものをろう付け手法によって埋込み固定して、

5

表面に40~60μmの砥粒歯が林立したもの。回転デ ィスクを駆動するモータの電力は3.7KW。回転数は 3,400回転/分。

- (3) 固定ディスクの中心と回転デイスクの回転軸のず れPは25mm。三日月形の露出部の最大幅Nは50m
- (4) 粉砕原料は稲籾がら。前処理によって3つ割り乃 至5つ割りにしたもの。含水率11%。
- (5) 粉砕原料の通過速度は25kg/hr、粉砕効果 $t140 \mu m \ge t98\%$, $100 \mu m \ge t87\%$, 60 $\mu m \ge 562\%$, $40 \mu m \ge 53\%$, $20 \mu m \ge 54$ 6%であった。
- (6)空冷の方法は、負圧が2,300mmAq、風量 が1m3/分。誘導された空気は粉砕物を乗せて運ぶの で、粉砕物の搬出用メディアとしての効用をも兼ねるも のである。
- (7)室温23℃で試験し、赤外線放射式温度計で測定 したが、回転ディスクにおける温度変化は、運転開始後 20分で25℃、40分後で29℃、60分後で32 を越えることがなかった。

上記試験結果によれば、回転ディスクの蓄熱を極めて少 ないものに押さえることができた。

【0014】 [比較例] 固定ディスクの中心軸と回転デ ィスクの回転軸を同一軸上に配し、固定ディスクをアラ ンダム、回転ディスクを金属円盤に超硬金属粒(WC) を固定したツールとしたグラインダを組み込んだ微粉砕 機により、稲籾がらを粉砕した。固定ディスクと回転デ ィスクのクリアランスは40~60 µm。室温20℃の 時、回転ディスクの研削面の表面温度は、運転開始後5 分後で35℃、10分後で45℃、20分後で75℃、 40分後で100℃、60分後で120℃に達した。そ の熱を放熱させるため空気を圧送したが、固定ディスク と回転ディスクのクリアランスがなく、大量の空気の通 過が不能であったため、8~10%程度の冷却効果に留 まり、冷却効果が上がらなかった。従って、この粉砕機 は熱によって変質し易い物質の粉砕には適当でないこと が判明した。

【0015】 [試験例2] 上記試験例1に用いたものと る茶葉の粉砕を行った(茶葉を発熱下で粉砕すると風味 がそこなわれ易い。このため、茶葉の粉砕は発熱を嫌う ことが知られており、茶葉の風味を維持するため、石臼 を60~100回転/分程度でゆっくり回転しながら粉 砕している。このため、この石臼による粉砕方法は生産 性が極めて悪い)。

- (1) 固定デイスクは凹型。外径Mは190mm。材質 はアランダム。粒度は80番。含みTの高さは中心より 45mmの円周部で4mm(図9参照)。
- (2)回転デイスクの研削面は水平。外形Lは240m 50 易い物質(例えば、食品、植物、動物、微生物、薬品

6

m。ステンレス製台金上にダイヤモンド粒(またはCB N粒)のサイズ80番の微粒を固定して、表面に30~ 40 μmの砥粒歯が林立したもの。回転ディスクを駆動 するモータの電力は3.7KW。回転数は3,400回 転/分。

- (3) 固定ディスクの中心と回転デイスクの回転軸のず れPは25mm。三日月の露出部の最大幅Nは50m
- (4) 粉砕原料は煎茶。含水率6%。
- (5) 粉砕原料の通過速度は32kg/hr、粉砕効果 は100 μ m \ge が100%、60 μ m \ge が86%、40 $\mu \, \text{m} \ge 574\%$, $20 \, \mu \, \text{m} \ge 52\%$, $10 \, \mu \, \text{m} \ge 54$ 1%であった。
- (6) 空冷の方法は、負圧が2,300mmAq、風量 が1m3/分。誘導された空気は粉砕物を乗せて運ぶの で、粉砕物の搬出用メディアとしての効用を兼ねるもの である。
- (7) 室温20℃で試験し、赤外線放射式温度計で測定 したが、回転ディスクにおける温度変化は、運転開始後 ℃、90分後で35℃、以後連続運転7時間の間36℃ 20 20分で23℃、40分後で25℃、60分後で28 ℃、以後連続運転7時間の間、32℃を越えることがな かった。

上記試験結果によれば、粉砕時に回転ディスクの著しい 温度上昇がなかったため、茶葉の微粉末は風味と香りの 状態が良好で、石臼による粉砕品と比べて何ら遜色がな

- 【0016】 [試験例3] 上記試験例1、2に用いたも のと同じ微粉砕機を用いて、石灰石の粉砕を行った。粉 砕原料の石灰石はクラッシャによって破砕された1~3 30 mmに篩分けた砂状のものを用いた。
 - (1) 粉砕原料の通過速度は35kg/hr、粉砕効果 は100μm≥が100%、60μm≥が83%、40 μ m≧が65%であった。
 - (2)回転ディスクにおける温度変化は、運転開始後6 0分で42℃、90分後で48℃、以後連続運転3時間 の間、50℃を越えることがなかつた。

【0017】なお、上記の試験例においては粉砕物の例 として、稲籾がら、茶葉、石灰岩の例を示したが、この グラインダは食品、薬品、塗料、各種鉱物、セラミック 同じ微粉砕機を用いて、微妙な風味と香りが問題とされ 40 ス、金属、電子材料、有機高分子材料、微生物、動物細 胞、植物細胞等の微粉砕にも利用できる。

【発明の効果】本発明は、上述の通り構成されているの で、次に記載する効果を奏する。

(1)回転ディスクの研削面が回転毎に固定ディスクか ら離れ空気に触れて放熱し、その後再び固定ディスクに もぐり込む動作を繰り返すことによって回転ディスクへ の蓄熱を防ぐため、粉砕中に粉砕ツールである回転ディ スクに生じる熱の蓄積が低く押さえられ、熱変成の生じ 7

等)を粉砕するときでも、温度の影響を与えずに常温化 での粉砕が可能である。

(2) 固定ディスクの中心軸と回転ディスクの回転軸をずらせて異軸上に配置し、回転ディスクの研削面が異軸上に位置する固定ディスクの研削面との間で、軸のずれ分だけ移動しながら動くことになるため、研削用カッティング歯の摩耗が同心の狭帯状に起こらず、軸のずれの距離の2倍の幅で粉砕カッティング部の摺れ合いが分散して起こることになる;又、発熱が抑制される結果、熱による膨張収縮によって起る研削用カッティング歯を固定する部材の疲労が少ない;ことがあいまって回転ディスクの長寿命化が可能となる。

(3)回転ディスクが蓄熱し回転ディスクの回転軸が熱によって伸長し固定ディスクと回転ディスクの間隙が狭まり接触することによって生じるオーバーヒートがないため、正確かつ精密な粉砕が可能となる。

(4) 粉砕に寄与する研削面は1回転毎に露出し、噴射空気により清掃されるため、粉砕ツールの目詰まりを回避でき、粉砕作業と粉砕物の通過をスムースに行える。

(5) 回転ディスクの台を金属製とし、その表面にダイヤモンド、CBN又は超硬金属粒を埋込んで研削面を形成してあるため、耐久性に優れ、カッティング粉砕が可能でしかも粉砕物の粒径を均一に保持できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術のグラインダを示し、(a) はその断面略図、(b) はその平面略図である。

【図2】図1のグラインダの要部拡大図を示し、(a) は粉砕物の研削が研削面の同じ円周上で行われ研削面の

外周部が摩耗した状態を示す断面略図、(b)はその平 面略図である。

【図3】本発明に係るグラインダを示し、(a) はその 断面略図、(b) は平面略図である。

【図4】本発明に係るグラインダと本発明を構成する冷却手段の位置関係を示す断面略図である。

【図5】本発明に係るグラインダの他の例を示し、(a)はその断面略図、(b)は平面略図である。

【図 6 】図 3 に示すグラインダの要部を示し、(a)は 10 その断面略図、(b)は平面略図である。

【図7】本発明に係るグラインダの他の例を示し、(a)はその断面略図、(b)は平面略図である。

【図8】本発明に係るグラインダのもう一つ他の例を示し、(a) はその断面略図、(b) は平面略図である。

【図9】本発明に係るグラインダの更にもう一つ他の例を示し、(a)はその断面略図、(b)は平面略図である。

【図10】図9に示すグラインダを組み込んで構成した 微粉砕機の断面略図を示す。

20 【符号の説明】

 10
 グラインダ

 13、23、43
 回転ディスク

 14、24、34、44
 固定ディスク

 15、45
 研削而

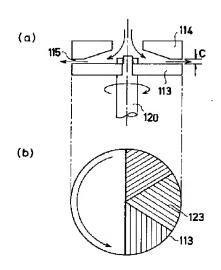
 16、26
 供給口

 19、29、49
 露出面

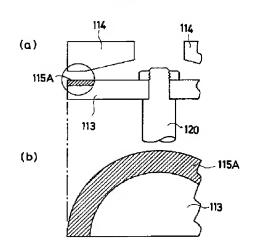
 20
 シャフト

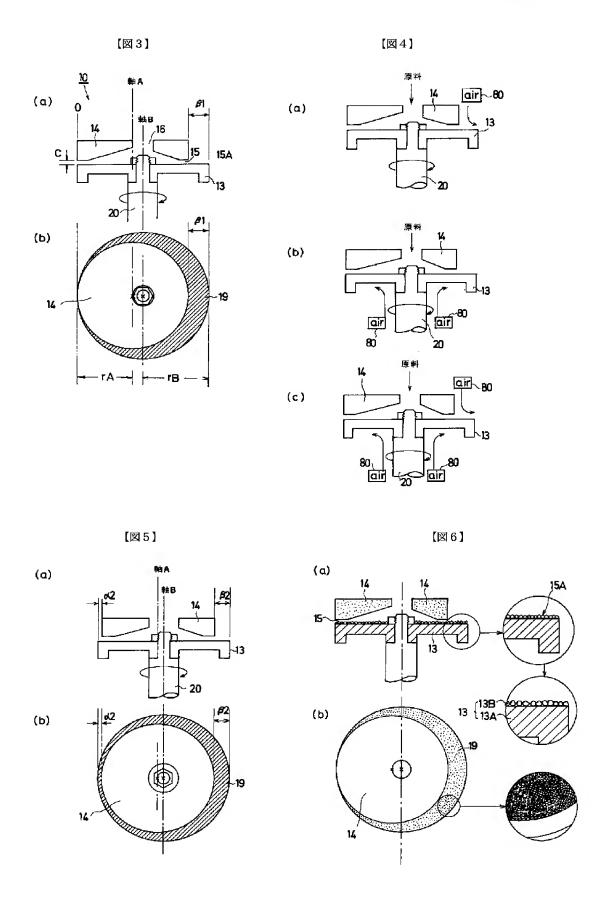
 80
 冷却手段

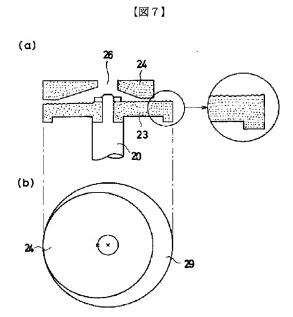
【図1】

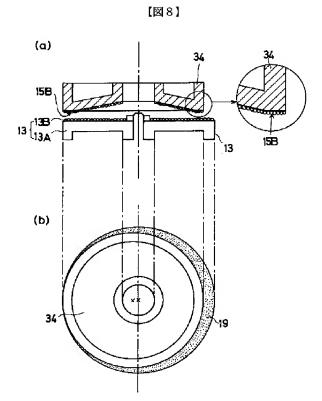


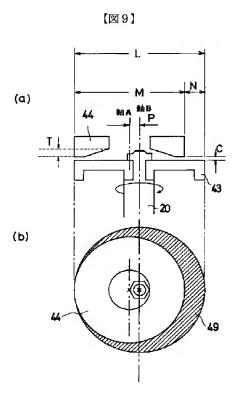
[図2]











【図10】

